**2020年中国氟硅新材料技术与应用发展研讨会**

**参会回执表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 职称/职务 | |  | | | 手机 | |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 职称/职务 | |  | | | 手机 | |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 职称/职务 | |  | | | 手机 | |  |
| 单位 |  | | | 地址 | |  | | | | | |
| 电话 |  | 传真 |  | | | | E-mail | | |  | |
| 住宿 | 标准间（ ） 单间（ ） | | | | 订房日期 | | | 日至 日 共 晚 | | | |
| 户 名：中国氟硅有机材料工业协会  开户行：交通银行北京德胜门支行  账 号：110060211012015025724  用 途：2020氟硅新材料会议 | | | | | | | | | | | |
| 备注 | 为便于在会议期间拿到发票，可将会务费汇至上述帐号。 | | | | | | | | | | |

说明：请于2020年11月20日前将回执Email至会务组。

会务组联系方式如下：

苏 琴13501849022（微同） 杨 岱18817595234

孙 芳13330806258（微同） 王姝兰13890066083

E-mail：youjifu\_zgfg@126.com 或 zgfgtl@126.com。